

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 4 月 7 日 (07.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/030896 A1

(51) 国際特許分類⁷: C09J 177/00, 7/02, H05K 3/38, 3/46

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/006259

(22) 国際出願日: 2004 年 5 月 11 日 (11.05.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-336243 2003 年 9 月 26 日 (26.09.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本化薬株式会社 (NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1028172 東京都千代田区富士見一丁目 11 番 2 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 内田 誠 (UCHIDA, Makoto) [JP/JP]; 〒1150042 東京都北区志茂 3 丁目 2 6-8 日本化薬株式会社 機能化学品開発研究所内 Tokyo (JP). 浅野 豊文 (ASANO, Toyofumi) [JP/JP]; 〒1150042 東京都北区志茂 3 丁目 2 6-8 日本化薬株式会社 機能化学品開発研究所内 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

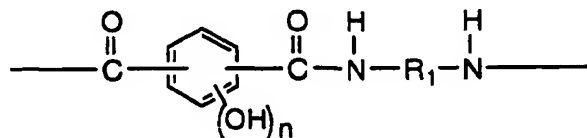
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ADHESIVE AID COMPOSITION

(54) 発明の名称: 接着補助剤組成物



(1)

(57) Abstract: An adhesive aid composition which has excellent strength of bonding to polyimide films, etc. without lowering mechanical properties and is useful in the field of electrical materials. The

adhesive aid composition comprises a polyamide containing phenolic hydroxy groups and a solvent as essential ingredients. The polyamide containing phenolic hydroxy groups preferably is one having segments represented by the following formula (1): (1) (wherein R₁ represents a divalent aromatic group and n, indicating the average number of the substituents, is a positive number of 1 to 4). The adhesive aid composition is suitable for use in the bonding of polyimide films.

[続葉有]

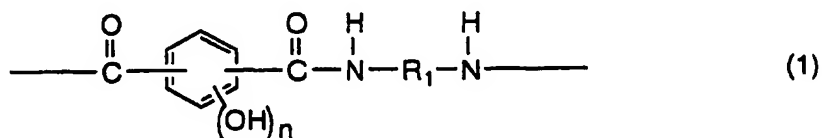


WO 2005/030896 A1



(57) 要約:

本発明は、ポリイミドフィルム等に対し、機械特性を低下させることなく、接着強度に優れた、電気材料分野で有用な接着補助剤組成物を提供することを目的とする。本発明の接着補助剤組成物は、フェノール性水酸基含有ポリアミドと溶剤を必須成分とする。フェノール性水酸基含有ポリアミドとしては、下記式(1)



(式(1)中 R_1 は2価の芳香族基を表し、 n は平均置換基数であって1〜4の正数を表す。)で表されるセグメントを持つものが好ましい。本発明の接着補助剤組成物は、ポリイミドフィルムの接着に好適に使用される。